2026-2031年中国半导体光刻胶行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：半导体光刻胶行业综述及数据来源说明
1.1 光刻胶行业界定
1.1.1 光刻胶的定义
1.1.2 光刻是半导体制造微图形工艺的核心，光刻胶是关键材料
1.1.3 光刻胶技术参数
1.1.4 光刻胶所处行业
1.1.5 按下游应用分类
1、半导体光刻胶
2、显示光刻胶
3、PCB光刻胶
4、其他
1.2 半导体光刻胶行业分类
1.3 本报告研究范围界定说明
1.4 光刻胶行业市场监管&标准体系
1.4.1 光刻胶行业监管体系及机构职能
1.4.2 光刻胶行业标准体系及建设进程
1、光刻胶行业现行国家标准建设现状
2、光刻胶行业现行企业标准建设现状
（1）光刻胶行业现行企业标准汇总
（2）光刻胶行业现行企业标准分析
1.5 本报告数据来源及统计标准说明
1.5.1 本报告权威数据来源
1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明
——现状篇——
第2章：全球半导体光刻胶行业发展现状及趋势洞察
2.1 全球光刻胶行业发展历程
2.1.1 萌芽期
2.1.2 初步发展期
2.1.3 快速发展期
2.2 全球光刻胶技术进展及产品研发进度
2.2.1 全球半导体光刻胶技术进展情况
2.2.2 全球半导体光刻胶厂商产品研发进度
2.3 全球半导体光刻胶行业发展现状分析
2.3.1 全球半导体光刻胶工厂分布
2.3.2 全球半导体光刻胶量产进度
2.3.3 全球半导体光刻胶细分市场
2.3.4 全球半导体产业发展现状及光刻胶需求分析
2.4 全球半导体光刻胶行业市场竞争状态及格局分析
2.4.1 全球光刻胶行业兼并重组状况
2.4.2 全球半导体光刻胶行业市场竞争格局
2.4.3 全球半导体光刻胶行业市场集中度
2.4.4 全球半导体光刻胶行业区域发展格局
2.4.5 全球半导体光刻胶重点区域市场分析
1、美国
2、日本
2.5 全球半导体光刻胶行业市场规模体量及前景预判
2.5.1 全球半导体光刻胶行业市场规模体量
2.5.2 全球半导体光刻胶行业市场前景预测（未来5年预测）

2.5.3 全球半导体光刻胶行业发展趋势洞悉
2.6 全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴
第3章：中国半导体光刻胶行业发展现状及市场痛点
3.1 中国半导体光刻胶行业发展历程
3.2 中国半导体光刻胶行业技术进展
3.2.1 半导体光刻胶行业科研投入（力度及强度）
3.2.2 半导体光刻胶行业科研创新（专利与转化）
3.2.3 半导体光刻胶行业关键技术（现状与突破）
3.2.4 半导体光刻胶制备过程
3.3 中国半导体光刻胶行业对外贸易状况
3.3.1 海关总署——半导体光刻胶归类
3.3.2 中国光刻胶进出口贸易概况（过去5年数据）
3.3.3 中国光刻胶进口贸易状况（过去5年数据）
1、光刻胶行业进口贸易规模
2、光刻胶行业进口价格水平
3、光刻胶行业进口产品结构
3.3.4 中国光刻胶出口贸易状况（过去5年数据）
1、光刻胶行业出口贸易规模
2、光刻胶行业出口价格水平
3、光刻胶行业出口产品结构
3.3.5 中国光刻胶行业进出口贸易影响因素及发展趋势
3.4 中国半导体光刻胶行业市场主体
3.4.1 半导体光刻胶行业市场主体类型
3.4.2 半导体光刻胶行业企业入场方式
3.5 中国半导体光刻胶行业市场供给分析
3.5.1 半导体光刻胶企业仍然较少
3.5.2 光刻胶产量（万吨）
3.5.3 半导体光刻胶主要企业产能
3.6 中国半导体光刻胶行业市场需求分析
3.6.1 半导体光刻胶需求量（万吨）
3.6.2 半导体光刻胶行业自给率
3.6.3 半导体光刻胶市场行情走势
3.7 中国半导体光刻胶行业市场规模体量
3.7.1 中国光刻胶行业市场规模体量
3.7.2 半导体光刻胶行业市场规模体量
3.8 中国半导体光刻胶行业市场竞争格局
3.8.1 中国半导体光刻胶行业企业竞争格局
3.8.2 中国半导体光刻胶行业市场集中度
3.9 中国半导体光刻胶国产替代布局现状
3.9.1 中国半导体光刻胶国产替代必然性分析
1、半导体光刻胶处于各行业产业链上游，具有举足轻重的地位
2、半导体材料国产化的必然趋势
3、光刻胶国产代替是中国半导体产业的迫切需要
3.9.2 中国半导体光刻胶国产替代现状
3.9.3 中国半导体光刻胶国产替代趋势
3.10 中国半导体光刻胶行业市场发展痛点
第4章：半导体光刻胶产业链全景及配套产业发展
4.1 半导体光刻胶产业链结构梳理
4.2 半导体光刻胶产业链生态图谱
4.3 半导体光刻胶产业链区域热力图
4.4 半导体光刻胶行业成本投入结构
4.4.1 光刻胶在半导体成本中的比重
4.4.2 光刻胶原材料构成及主要作用
4.4.3 半导体制造材料成本结构
4.4.4 日本和美国主导全球光刻胶原材料市场
4.5 光刻胶原材料：光刻胶单体及树脂
4.5.1 光刻胶用树脂类型及特征
4.5.2 光刻胶单体概述
4.5.3 树脂市场供应情况

1、产品供应情况
2、产品供应商情况
3、产品价格情况
4.5.4 光刻胶用树脂发展趋势
4.6 光刻胶原材料：光敏材料
4.6.1 光刻胶用光敏材料概述
1、光引发剂
2、光致产酸剂——光酸（PAG）
4.6.2 光引发剂市场供应情况
1、产品供应情况
2、产品供应商情况
3、产品价格情况
4.6.3 光刻胶用光引发剂发展趋势
4.7 光刻胶原材料：溶剂
4.7.1 光刻胶用溶剂概述
4.7.2 溶剂市场供应情况
1、产能建设及产品应用情况
2、产品供应情况
3、产品供应商情况
4、产品价格情况
4.7.3 光刻胶用溶剂发展趋势
4.8 光刻胶原材料：其他助剂
4.9 配套产业布局对半导体光刻胶行业的影响总结
第5章：中国半导体光刻胶行业细分产品市场分析
5.1 中国半导体光刻胶行业细分市场概况
5.1.1 中国半导体光刻胶行业细分市场对比
5.1.2 中国半导体光刻胶行业细分市场结构
5.2 半导体光刻胶细分市场：G线光刻胶
5.2.1 G线光刻胶概述
5.2.2 G线光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.3 半导体光刻胶细分市场：I线光刻胶
5.3.1 I线光刻胶概述
5.3.2 I线光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.4 半导体光刻胶细分市场：KrF光刻胶
5.4.1 KrF光刻胶概述
5.4.2 KrF光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.5 半导体光刻胶细分市场：ArF光刻胶
5.5.1 ArF光刻胶概述
5.5.2 ArF光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.6 半导体光刻胶细分市场：EUV光刻胶
5.6.1 EUV光刻胶概述
5.6.2 EUV光刻胶市场简析
1、主要企业
2、市场规模
3、国产化进程
5.7 中国半导体光刻胶行业细分市场影响因素及发展趋势
5.7.1 半导体光刻胶细分市场影响因素

5.7.2 半导体光刻胶细分市场发展趋势
5.8 中国半导体光刻胶行业细分市场战略地位分析
第6章：中国半导体光刻胶行业细分应用市场分析
6.1 半导体产业市场现状
6.1.1 全球半导体产业向中国大陆转移
6.1.2 中国半导体产业市场规模
6.1.3 中国半导体产业细分市场
6.1.4 中国集成电路市场规模
6.1.5 中国集成电路市场结构
6.2 中国半导体产业趋势前景
6.2.1 中国半导体产业前景预测
6.2.2 中国半导体产业发展趋势
6.3 半导体光刻胶细分应用领域分布
6.4 半导体光刻胶细分应用：逻辑IC
6.4.1 逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述
6.4.2 逻辑IC市场现状及发展趋势
1、逻辑IC市场现状
2、逻辑IC发展趋势
6.4.3 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场现状
6.4.4 逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力
6.5 半导体光刻胶细分应用：动态随机存取存储器（DRAM）
6.5.1 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用概述
6.5.2 动态随机存取存储器（DRAM）市场现状及发展趋势
1、动态随机存取存储器（DRAM）市场现状
2、动态随机存取存储器（DRAM）发展趋势
6.5.3 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场现状
6.5.4 动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场潜力
6.6 半导体光刻胶细分应用：NVM（非易失性内存）
6.6.1 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用概述
6.6.2 NVM（非易失性内存）市场现状及发展趋势
1、NVM（非易失性内存）市场现状
2、NVM（非易失性内存）发展趋势
6.6.3 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场现状
6.6.4 NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场潜力
6.7 中国半导体光刻胶行业细分应用市场战略地位分析
第7章：全球及中国半导体光刻胶企业布局案例解析
7.1 全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理
7.2 全球半导体光刻胶主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）
7.2.1 日本合成橡胶（JSR）
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.2 日本信越化学
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.3 日本东京应化（TOK）
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.4 美国杜邦
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.2.5 日本富士胶片

1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶业务布局&发展现状
4、企业半导体光刻胶业务销售&在华布局
7.3 中国半导体光刻胶主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）
7.3.1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.2 晶瑞电子材料股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.3 深圳市容大感光科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.4 江苏南大光电材料股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.5 上海新阳半导体材料股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.6 彤程新材料集团股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.7 厦门恒坤新材料科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.8 上海飞凯材料科技股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术

5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.9 北京欣奕华科技有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
7.3.10 北京科华微电子材料有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业半导体光刻胶产品/产线布局
4、企业半导体光刻胶专利技术
5、企业半导体光刻胶产销情况/客户
6、企业半导体光刻胶业务布局战略&优劣势
——展望篇——
第8章：中国半导体光刻胶行业发展环境洞察&SWOT分析
8.1 中国半导体光刻胶行业经济（Economy）环境分析
8.1.1 中国宏观经济发展现状
8.1.2 中国宏观经济发展展望
8.1.3 中国半导体光刻胶行业发展与宏观经济相关性分析
8.2 中国半导体光刻胶行业社会（Society）环境分析
8.2.1 中国半导体光刻胶行业社会环境分析
8.2.2 社会环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结
8.3 中国半导体光刻胶行业政策（Policy）环境分析
8.3.1 国家层面半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
1、国家层面半导体光刻胶行业政策汇总及解读
2、国家层面半导体光刻胶行业规划汇总及解读
8.3.2 31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
1、31省市半导体光刻胶行业政策规划汇总
2、31省市半导体光刻胶行业发展目标解读
8.3.3 国家重点规划/政策对半导体光刻胶行业发展的影响
8.3.4 政策环境对半导体光刻胶行业发展的影响总结
8.4 中国半导体光刻胶行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）
第9章：中国半导体光刻胶行业市场前景及发展趋势分析
9.1 中国半导体光刻胶行业发展潜力评估
9.2 中国半导体光刻胶行业未来关键增长点分析
9.3 中国半导体光刻胶行业发展前景预测（未来5年预测）
9.4 中国半导体光刻胶行业发展趋势预判
9.4.1 中国半导体光刻胶行业市场竞争趋势
9.4.2 中国半导体光刻胶行业技术创新趋势
9.4.3 中国半导体光刻胶行业细分市场趋势
1、EUV光刻胶的比重将会提升
2、ArF光刻胶国产替代有望加快
第10章：中国半导体光刻胶行业投资战略规划策略及建议
10.1 中国半导体光刻胶行业进入与退出壁垒
10.1.1 半导体光刻胶行业进入壁垒分析
1、技术壁垒（配方技术、质量控制技术和原材料技术）
2、客户认证壁垒
3、设备壁垒
4、原材料壁垒
5、资金壁垒
6、资质壁垒
10.1.2 半导体光刻胶行业退出壁垒分析
10.2 中国半导体光刻胶行业投资风险预警
10.3 中国半导体光刻胶行业投资机会分析
10.3.1 半导体光刻胶产业链薄弱环节投资机会
10.3.2 半导体光刻胶行业细分领域投资机会

10.3.3 半导体光刻胶行业区域市场投资机会
10.3.4 半导体光刻胶产业空白点投资机会
10.4 中国半导体光刻胶行业投资价值评估
10.5 中国半导体光刻胶行业投资策略与建议

图表目录

图表1：光刻胶的定义
图表2：一种NMOS三极管集成电路结构的制造过程
图表3：半导体光刻胶涂抹方法
图表4：光刻胶主要技术参数
图表5：本报告研究领域所处行业
图表6：光刻胶行业所属的国民经济分类
图表7：光刻胶专业术语
图表8：光刻胶概念辨析
图表9：光刻胶按下游应用分类
图表10：半导体光刻胶产品分类及特征
图表11：半导体光刻胶行业分类
图表12：本报告研究范围界定
图表13：光刻胶行业监管体系及机构介绍
图表14：GB/T 16527-2025年（硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂）基本内容
图表15：晶瑞电材光刻胶企业标准汇总
图表16：Q/320506 ZRH47-2020（I线正性光刻胶）部分产品标准内容
图表17：本报告权威数据资料来源汇总
图表18：本报告的主要研究方法及统计标准说明
图表19：全球光刻胶行业在萌芽期的重要事件
图表20：全球光刻胶行业在初步发展期的重要事件
图表21：全球光刻胶行业在快速发展期的重要事件
图表22：全球半导体光刻胶技术进展情况
图表23：全球半导体光刻胶厂商产品研发进度情况
图表24：全球半导体光刻胶工厂分布情况
图表25：全球半导体光刻胶行业主要企业生产进度
图表26：全球半导体光刻胶行业细分产品应用占比（单位：%）
图表27：全球光刻胶应用结构（单位：%）
图表28：全球光刻胶行业主要兼并、重组事件
图表29：全球光刻胶行业的竞争梯队（按市场份额）
图表30：全球光刻胶行业市场份额（单位：%）
图表31：全球半导体光刻胶行业细分市场竞争格局（单位：%）
图表32：全球光刻胶行业市场集中度（单位：%）
图表33：全球各地区半导体产能份额占比
图表34：全球半导体光刻胶行业重点区域市场分析
图表35：全球半导体光刻胶行业市场规模体量分析
图表36：全球光刻胶行业市场规模情况（单位：亿美元）
图表37：全球半导体光刻胶行业市场前景预测（未来5年预测）
图表38：全球半导体光刻胶行业发展趋势洞悉
图表39：全球半导体光刻胶行业发展经验总结和有益借鉴
图表40：日本光刻胶产业崛起因素简析
图表41：中国半导体光刻胶行业发展历程
图表42：半导体光刻胶行业科研投入状况（研发力度及强度）
图表43：半导体光刻胶行业科研投入（力度及强度）
图表44：半导体光刻胶行业科研创新（专利与转化）
图表45：半导体光刻胶行业关键技术（现状与发展）
图表46：半导体光刻胶生产工艺流程
图表47：半导体光刻胶行业市场主体类型
图表48：半导体光刻胶行业企业入场方式
图表49：半导体光刻胶行业市场主体数量

图表50：半导体光刻胶注册/在业/存续企业
图表51：中国光刻胶生产企业类型结构（单位：%）
图表52：中国半导体光刻胶行业市场供给分析
图表53：中国各类光刻胶产品生产企业分布情况
图表54：中国光刻胶行业市场供给分析
图表55：中国光刻胶产量及测算（单位：吨）
图表56：中国部分光刻材料项目建设进展情况
图表57：中国半导体光刻胶行业市场需求分析
图表58：中国半导体光刻胶自给率情况（单位：%）
图表59：中国光刻胶行业市场规模体量分析
图表60：中国光刻胶市场规模体量（单位：亿元）
图表61：中国半导体光刻胶市场规模（单位：亿美元）
图表62：中国半导体光刻胶行业市场规模体量分析
图表63：中国半导体光刻胶行业企业竞争格局分析
图表64：中国半导体光刻胶竞争格局（单位：%）
图表65：中国半导体光刻胶行业市场集中度分析
图表66：中国光刻胶国产替代现状
图表67：中国半导体光刻胶行业市场发展痛点分析
图表68：半导体光刻胶产业链结构梳理
图表69：光刻胶行业产业链示意图
图表70：半导体光刻胶产业链区域热力图
图表71：光刻胶基本成分介绍
图表72：光刻胶原材料用量及成本占比
图表73：光刻胶行业价值链分析图
图表74：光刻胶单体及树脂市场发展现状
图表75：应用于光刻胶的树脂中国市场供应商情况
图表76：中国光刻胶树脂供应商产能产量情况（单位：吨/年，万吨，%）
图表77：PCB光刻胶-树脂市场均价参考（单位：元/千克，%）
图表78：光刻胶原材料：光敏材料市场发展现状
图表79：光引发剂分类
图表80：2015-2025年中国光引发剂产量（单位：万吨）
图表81：中国光引发剂供应商情况
图表82：中国光刻胶光引发剂供应商产能情况（单位：吨/年，万吨/年，%）
图表83：容大感光光刻胶-光引发剂采购均价参考（单位：元/千克，%）
图表84：久日新材光刻胶-光引发剂销售均价参考（单位：元/千克，%）
图表85：PMA下游消费结构（单位：%）
图表86：PMA产能区域分布情况（单位：%）
图表87：中国PMA行业竞争情况（按产能）（单位：万吨/年）
图表88：容大感光光刻胶-溶剂采购均价参考（单位：元/千克，%）
图表89：原材料供应对半导体光刻胶行业的影响
图表90：中国半导体光刻胶行业细分市场结构
图表91：中国半导体光刻胶市场结构（单位：%）
图表92：中国G线光刻胶市场简析
图表93：中国I线光刻胶市场简析
图表94：中国KrF光刻胶市场简析
图表95：中国ArF光刻胶市场简析
图表96：中国半导体光刻胶行业细分市场战略地位分析
图表97：全球半导体产业迁移路径图及迁移结构
图表98：中国半导体产业销售额及其增长情况（单位：亿美元，%）
图表99：中国集成电路市场规模（单位：亿元，%）
图表100：中国集成电路市场结构（单位：%）
图表101：2026-2031年中国半导体行业销售额预测（单位：亿美元）
图表102：中国半导体产业发展趋势
图表103：逻辑IC领域半导体光刻胶应用概述
图表104：逻辑IC市场现状
图表105：逻辑IC发展趋势
图表106：逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场现状
图表107：逻辑IC领域半导体光刻胶应用市场潜力
图表108：动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用概述

图表109：动态随机存取存储器（DRAM）市场现状
图表110：动态随机存取存储器（DRAM）发展趋势
图表111：动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场现状
图表112：动态随机存取存储器（DRAM）领域半导体光刻胶应用市场潜力
图表113：NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用概述
图表114：NVM（非易失性内存）市场现状
图表115：NVM（非易失性内存）发展趋势
图表116：NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场现状
图表117：NVM（非易失性内存）领域半导体光刻胶应用市场潜力
图表118：半导体光刻胶行业细分应用波士顿矩阵分析
图表119：全球及中国半导体光刻胶主要企业布局梳理
图表120：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发展历程
略·····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！